

100% tout neuf et de haute qualité !!

Le flux de colophane est utilisé pour faciliter la soudure.

Il nettoie et prévient l'oxydation des métaux, ce qui permet à la soudure de créer des liaisons mécaniques et électriques solides et durables.

Il agit également comme un agent mouillant, augmentant le flux de soudure et l'efficacité du processus de soudure.

Parfait pour les téléphones mobiles, cartes PC et autres systèmes sophistiqués de soudage par flux de copeaux électroniques.

Caractéristiques

Produit: BST-706

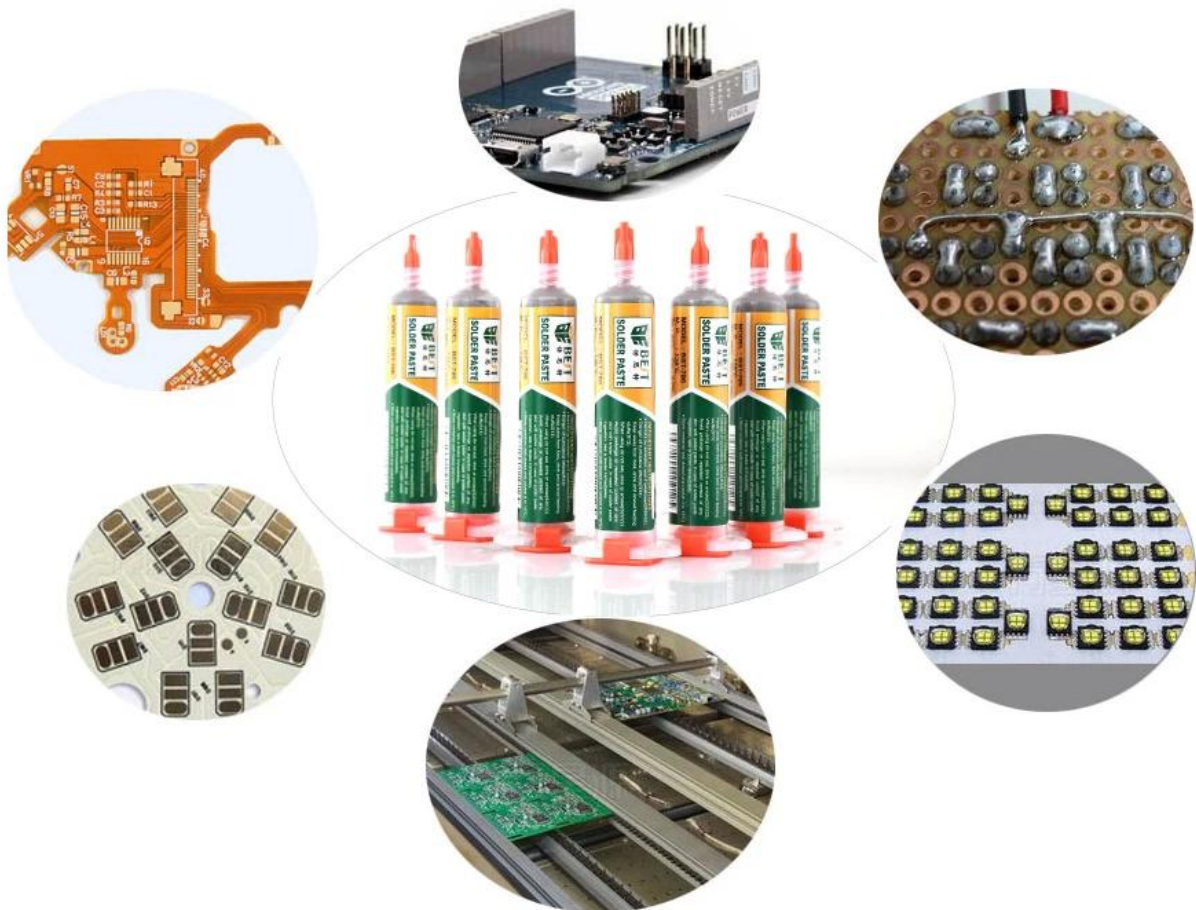
Point de fusion: 138 °C

Volume: 10cc

Poids: 38g

Ingrédients: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

PRODUCT USAGE



PRODUCT SIZE





Brand: BEST

Model Number:706

Melting point:138°C

Ingredients: Sn99% Cu0.7% Ag0.3%

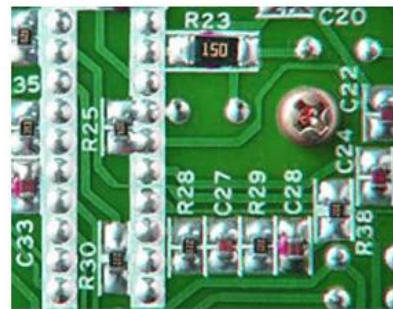
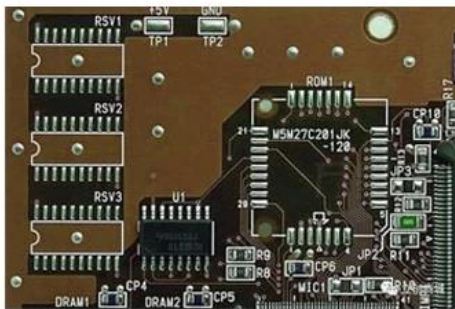
Volume:10cc

Weight: 38g

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue



PRODUCT PHOTOGRAPH



